

monoZ:Connect

ソフトバンクネットワーク対応のIoT NIDD通信デバイスのご紹介です。



monoZ:Connect

株式会社メリテック

NIDD対応デバイス

村田製作所1YS-SBモジュールを搭載

Softbank IoTプラットフォーム接続



スペック

製品名/型番	monoZ:Connect / MT-MZC1YS-002
内臓モジュール	村田製作所 1YS-SB
サイズ	21mm × 64mm × 29mm (H×W×D) アンテナコネクタ・SIMスロットカバー、取付突起部除く
重量	約50g
通信方式	LTE NB-IoT
通信機能	パケット通信方式
周波数	FDD-LTE：B1/8
電源電圧	DC 5V (USB)
消費電流	通信時：約200mA 待機時：約50mA
外部インターフェース	USB
制御コマンド	独自ATコマンド
動作環境	動作温度：0～40℃ 湿度：95%以下（結露なきこと）
その他機能	LwM2M over NIDDによるSoftBank IoT Platform Basicへの接続をサポート

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

<https://monoz.io/ja/products/monozconnect/>

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。